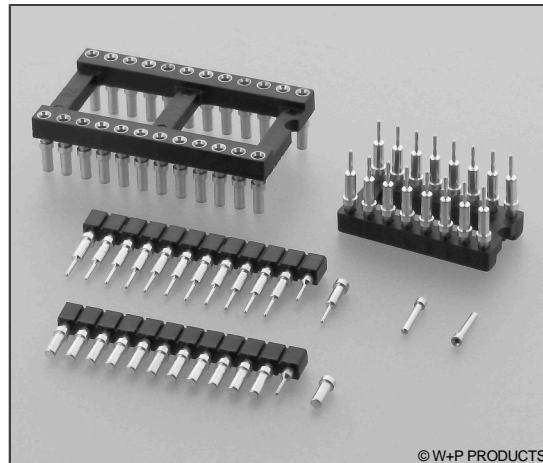


Einzelne IC-Buchsenkontakte, auf Kunststoffträger, RM 2,54mm Single IC Female Contacts on Plastic Holder, 2.54mm Pitch

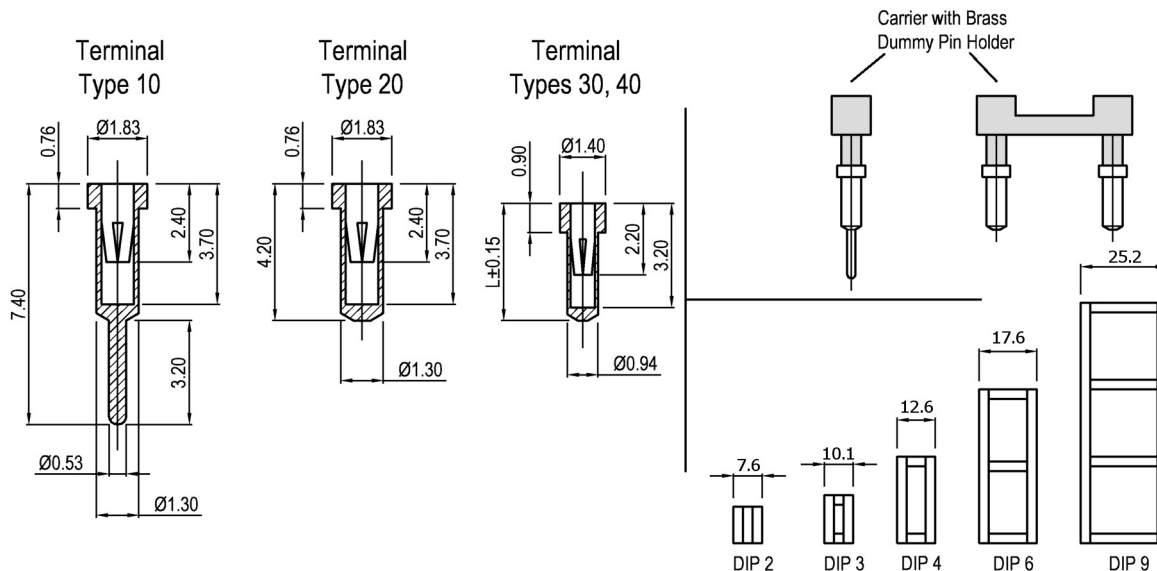
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Series 325	Contacts* 14	DIP Spacing* 9	Terminals* 10	Sleeve Plating 50	Clip Plating* 00
325 Träger IC-Fassungen <i>Carrier IC-Sockets</i>	10 =====> 06/08/10/ 12/14/16 ==>> 18/20/22/ 24/28/32 ==>>> 10/24/28/ 32/36/40/ 42/48/50/52=>>> 50/52/64 ==>>>	2 5,08mm 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 Mit Einlötlstift <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlstift <i>W/o solder tail</i>	50 Verzinkt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm (Option) <i>0.25µm gold plated (Option)</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

Series 325	Contacts* 18	Rows 1	Terminals* 10	Sleeve Plating 50	Clip Plating* 00
325 Träger IC-Leisten <i>Carrier IC-Headers</i>	01-64 Einreihig <i>Single row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i>	10 Mit Einlötlstift <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlstift <i>W/o solder tail</i> 30 L=3,7mm <i>L=3.7mm</i> 40 L=6,3mm <i>L=6.3mm</i>	50 Verzinkt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm (Option) <i>0.25µm gold plated (Option)</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

